



頌勝科技材料股份有限公司

2026年法人說明會

Precision | Vision | Innovation

連結全球產業鏈，開創半導體材料新未來

2026.09.01



免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息，係本公司蒐集外部經濟發展現況並整合內部資料後所得，僅反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性，故實際營運結果、財務狀況以及業務展望可能與前瞻性資訊有所差異，其原因來自於各種公司所不能掌控的風險。
- 本公司對於前瞻性資訊不作任何聲明或保證，除非法令另有要求外，本公司亦不因新資訊、未來事件或其他情事變更事由，負有主動更新前瞻性資訊的義務。



CONTENTS

簡報大綱

01 | 公司簡介

02 | 財務表現

03 | 營運概況及未來展望



關於頌勝科技材料

成立時間

1986年

資本額

7億 65萬元

主要產品

半導體研磨墊與耗材 66%

醫療與運動產品 26%

綠色環保黏著劑、PU 彈性體 8%

員工人數

約 801人(統計日截至2025/12)

總部

臺中市西屯區工業區14路2號



CONTENTS

簡報大綱

01 | 公司簡介

02 | 財務表現

03 | 營運概況及未來展望



綜合損益表-2026Q2 vs 2025Q2 vs 2025年度

綜合損益表項目

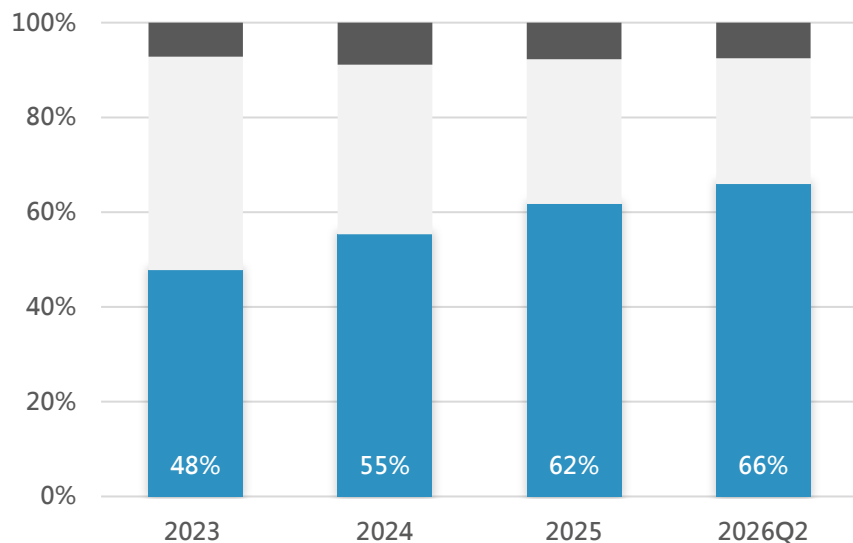
(除另予註明者外，金額以新台幣仟元)

	2026/1-6月	2025/1-6月	2025年度	年變化
營業收入淨額	1,129,571	1,018,796	1,980,776	+10.87%
營業毛利率	53.91%	50.45%	50.92%	+3.46%
營業費用	399,202	323,405	694,208	+23.44%
營業淨利	209,704	190,559	314,365	+10.05%
營業淨利率	18.56%	18.70%	15.87%	-0.14%
營業外收入及支出	81,646	(67,680)	(27,535)	+220.64%
歸屬予母公司業主之本期淨利	213,974	78,410	191,182	+172.89%
純益率	19.37%	8.17%	10.09%	+11.21%
每股盈餘(新台幣元)	3.32	1.35	3.24	1.97

經營績效

產品結構優化驅動毛利率持續上升

■ 半導體研磨墊與耗材
 ■ 醫療與運動產品
 ■ 環保黏著劑等



半導體產品營收占比變化

48% → 55% → 62% → 66%

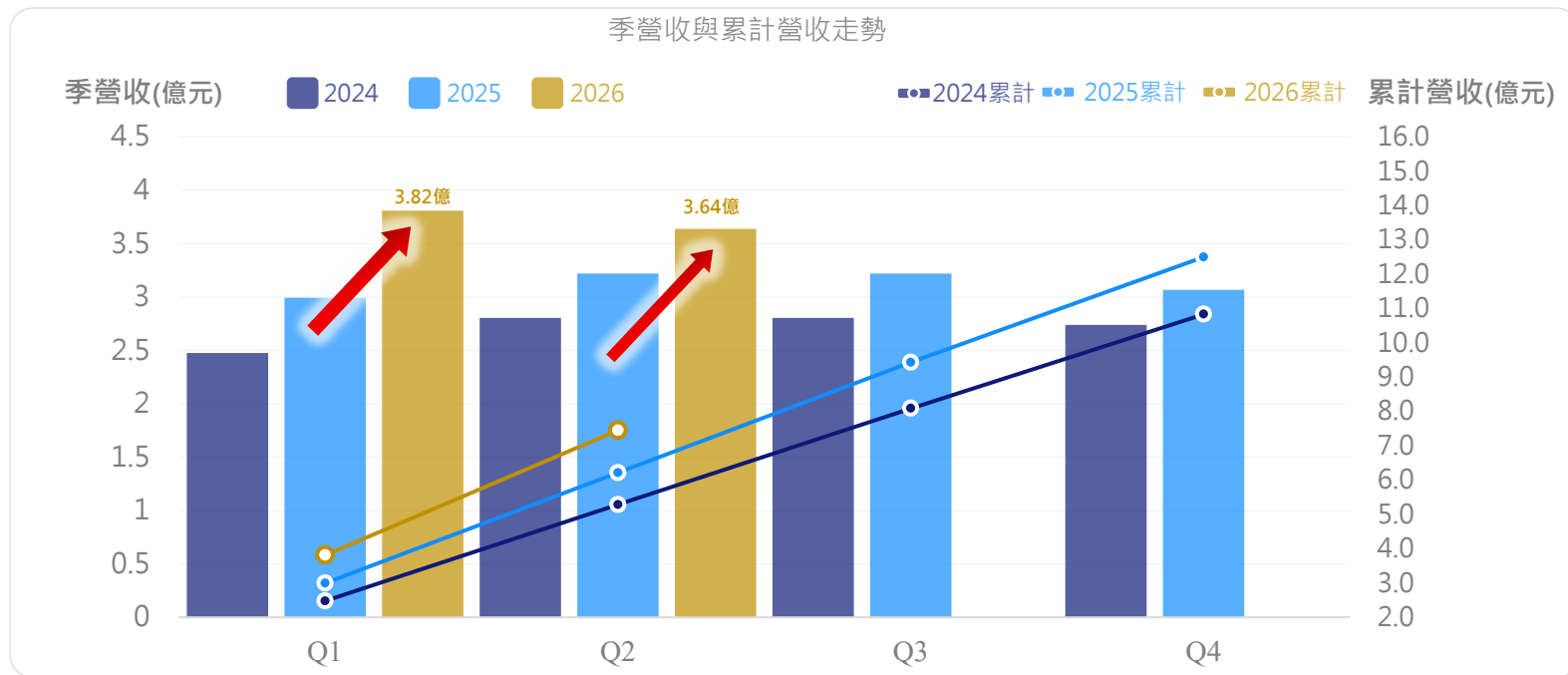
整體營業額成長動能

CAGR 25%

2023-2025營業複合成長率

經營績效

半導體業務趨勢：穩基礎、降波動、強成長



2024 – 2025：營收穩定，累計營收呈現穩定趨勢

2025：季節性效應低，營收波動變小，可預測性提升

2026：成長動能明確

經營績效

半導體業務：高基期穩成長，新動能再加速

2024 平均YoY

36%

高成長

2025 平均YoY

15%

穩延續

2026 平均YoY

25%

再加速

月營收(億元)

2024

2025

2026

YoY

1.5

1

0.5

0

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

70%

50%

30%

10%

-10%

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

- 連續三年平均維持雙位數成長
- 延續 2024 年 36% 的高基期，2025 年關稅變數下仍維持 15% 穩健成長
- 2026 年隨新動能發酵，下半年成長動能再度放大

資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目
(新台幣仟元)

	2026/6/30		2025/6/30		年變化
	金額	%	金額	%	
現金及有價金融商品投資	3,210,788	46.56%	1,404,184	44.20%	+128.66%
應收帳款	383,721	5.56%	394,461	12.42%	-2.72%
存貨	451,692	6.55%	338,496	10.66%	+33.44%
不動產、廠房及設備	2,378,802	34.50%	714,016	22.48%	+233.16%
其他	470,628	6.83%	325,397	10.24%	+44.63%
資產總計	6,895,631	100.00%	3,176,554	100.00%	+117.08%
流動負債	1,256,381	18.22%	1,336,290	42.07%	-5.98%
長期負債	1,117,381	16.20%	178,994	5.63%	+524.26%
負債總計	2,373,762	34.42%	1,515,284	47.70%	+56.65%
股東權益總計	4,521,869	65.58%	1,661,270	52.30%	+172.19%
重要財務指標					
流動比率(倍)	3.30		1.61		+105.28%
負債比率	34.42%		47.70%		-27.84%
平均收現日數	113.55		124.34		-8.68%

股利政策

2023-2025年度股利發放政策

年度	加權平均流通在 外股數(仟股)	EPS	現金股利	資本公積發 放現金	合計
2025	70,065	3.24	2.455	1.045	3.5
2024	60,000	4.42	3.45	-	3.45
2023	51,992	0.90	0.59	1.41	2.0

近三年股利維持穩定配發，最低配發率78%



CONTENTS

簡報大綱

01 | 公司簡介

02 | 財務表現

03 | 營運概況及未來展望



市場機會與策略

台灣與中國的雙策略引擎

China



Taiwan



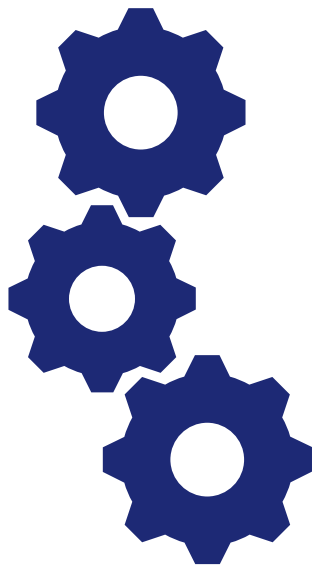
中國觀勝合肥新廠
中國市場擴張



台灣中科研發中心
全球市場



未來成長三引擎－半導體材料市場



引擎一：台灣新廠及研發中心擴大

- 預計每年需增加25%以上產能
- 加碼投資研究中心，擴大與客戶先進技術方面之合作
- 提早佈局新技術發展之產品應用
- 預計於2027Q2啟動中科新廠

引擎二：CMP Soft Pad新產線

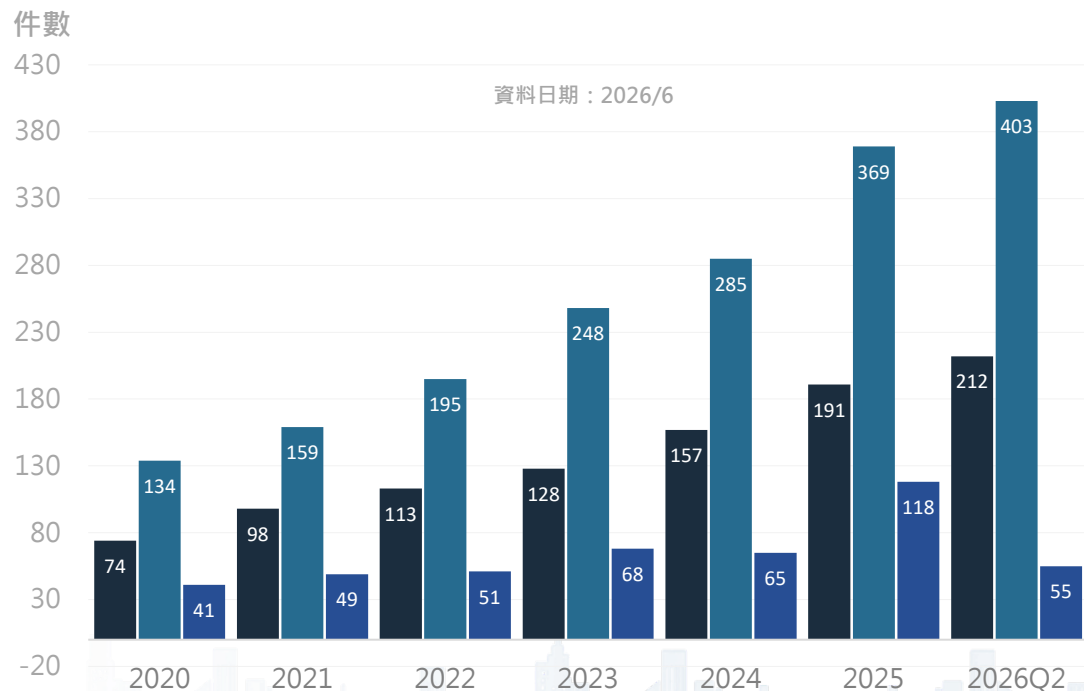
- 已於2024Q4設立新產品生產線
- 預計2026Q3試產、認證
- 預計2026Q4逐步量產

引擎三：觀勝合肥投資案

- 已於2024/03取得設立登記核可
- 已於2024/07注資，2024Q3動工
- 已於2026/6/17開幕
- 預計2026Q3試產、認證
- 預計2026Q4逐步量產

市場機會與策略

量產品穩定成長，研發數持續開案



新開專案

8.2%

55件

研發中專案

60.2%

403件

量產品

31.6%

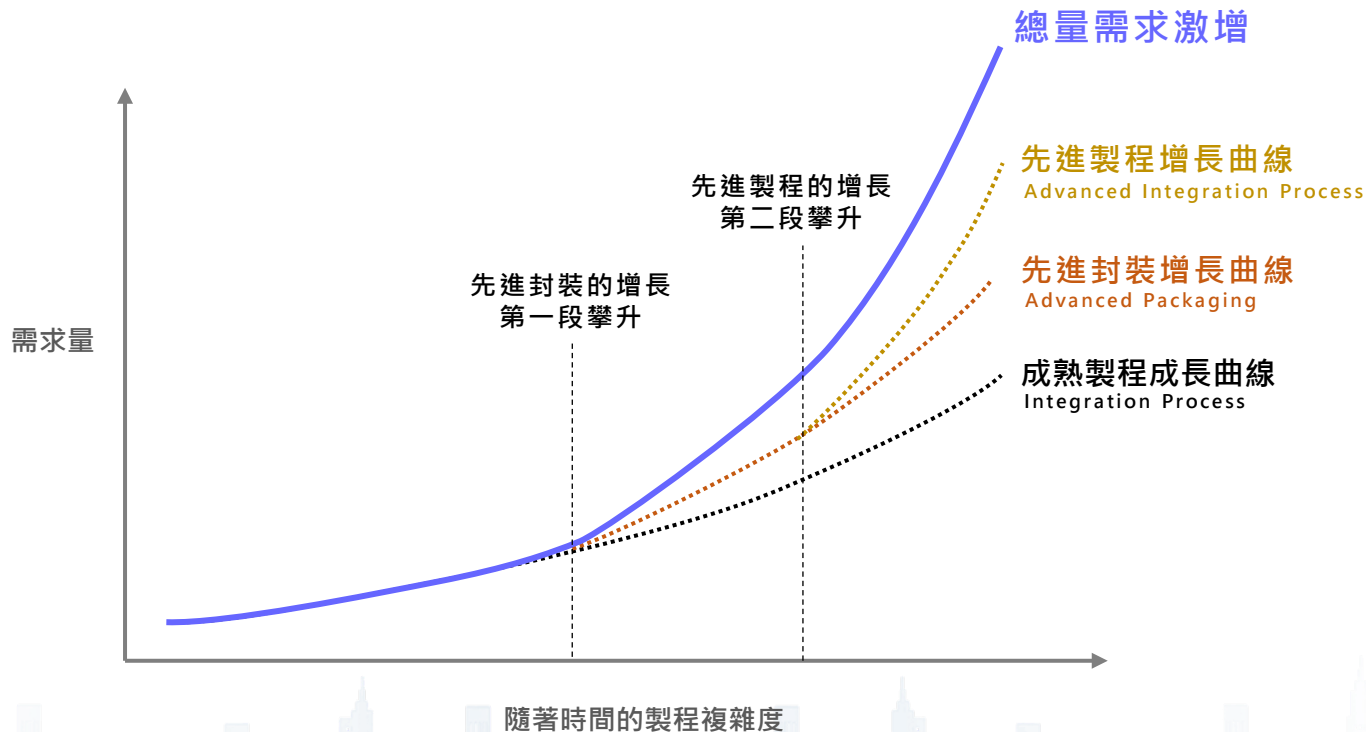
212件

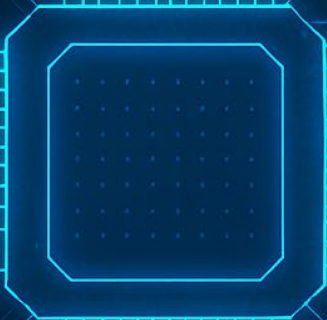
重點

- 量產品穩定增長
- 研發專案合作案持續轉量產
- 訂單逐步放大，推升營收

市場機會與策略

成熟製程 | 先進封裝 | 先進製程 的用量攀升三曲線





CMP is

Create Many
Possibilities

PVI on the Way